

X14 サーバーソリューション

AI、クラウド、ストレージ、5G/エッジのワークロード向けに、最大のパフォーマンス、効率性、柔軟性を実現するよう設計された、実績あるプラットフォームの最新世代



インテル® Xeon® 6 プロセッサをサポート

- インテル® Xeon® 6 プロセッサをベースとした業界で最も幅広いシステムのポートフォリオ
- ラックスケールのプラグアンドプレイサービスにより、数週間以内に完全な検証済みソリューションを提供
- CPU/GPU コールドプレート、冷却分配ユニット、冷却分配マニホールドを含む Supermicro の液冷システムによる完全に統合されたソリューション
- 世界で毎月最大 5,000 ラックの生産能力
- PCIe 5.0、DDR5、CXL 2.0、Open Compute Project (OCP) DC-MHS、OCP 3.0、EDSFF E3.S、E1.S ストレージフォームファクターなどの最新技術をサポート

X14 による究極のパフォーマンス、効率、柔軟性

Supermicro の X14 は、業界をリードするビルディングブロックソリューションと、トータルラックスケール液冷ソリューションを組み合わせることで、AI、HPC、クラウド、およびエッジのさまざまなワークロード向けに、カスタマイズされたワークロード最適化ソリューションを、あらゆる規模で提供します。今後リリース予定のインテル® Xeon® 6 プロセッサ（コードネーム：Sierra Forest および Granite Rapids）を搭載した Supermicro X14 は、ワットあたりのパフォーマンスおよびコアあたりのパフォーマンスを向上させ、あらゆるワークロードを高速化します。

実証済みのプラットフォーム、最適化されたワークロード

X14 は、Supermicro のインテル® Xeon® ベースのプラットフォームの最新世代であり、さまざまな業界や業種における広範な導入実績があります。

15 を超えるシステムファミリーから成る X14 ソリューションは、GPU アクセラレーションによる最新世代の生成 AI および HPC システムから、柔軟性の高いデータセンターおよびクラウドのラックマウント、効率化・最適化された通信 / エッジ用途の展開まで、あらゆるワークロードに最適化することができます。

ラックスケールにすぐに対応

Supermicro X14 は、業界で最も幅広いワークロードに最適化されたサーバーであるだけでなく、あらゆるワークロードに対応するカスタムソリューションをラックスケールで構築するための基盤でもあります。Supermicro は、全世界で毎月 5,000 ラック（1,350 の液冷 100kW ラックを含む）の生産能力を持ち、リードタイムが最短 2 週間という速さで、現在入手可能な最先端の AI ハードウェアを含む、完全にカスタマイズされたワークロード最適化ラックスケールソリューションを提供します。

柔軟性のあるモジュール式设计でオープン標準をサポート

Supermicro X14 システムは、Supermicro のビルディングブロックソリューションのモジュール式プラットフォームをベースとして、業界で最も柔軟なアーキテクチャとなるように一から設計されています。これにより、コンポーネントを容易にカスタマイズして、特定のワークロードに必要なさまざまな電力、ストレージ、I/O、アクセラレーション要件をサポートすることができます。さらに Supermicro は、OCP 3.0、DC-MHS、OAM、ORV2、OSF、Open BMC、CXL、EDSFF E1.5 および E3.S ストレージフォームファクターなど、新しい業界標準とオープンアーキテクチャをいち早く採用してきました。

インテル® Xeon® 6 プロセッサ搭載

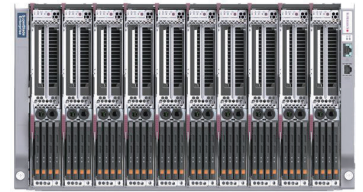
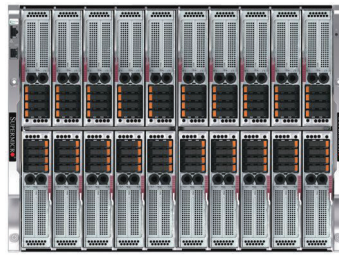
Supermicro X14 は、新世代のインテル® Xeon® 6 プロセッサを今後サポートすることで柔軟性を一段と高め、プロセッサレベルでのワークロード最適化を実現します。クラウドネイティブおよびスケールアウトワークロード向けの、E-cores 搭載インテル® Xeon® 6 プロセッサに対応したシステムは、ラックユニットあたりのコア密度を高め、膨大な計算能力を必要とせず多数のインスタンスを同時に実行できるワークロードに最適で、ワットあたりのパフォーマンスを向上させます。

Supermicro のビルディングブロックと同様に、E-cores 搭載インテル® Xeon® 6 プロセッサは、1つの CPU でコア数を最大化し、それらのコアのワットあたりのパフォーマンスを最大化するために、ワークロードが必要としない機能を見送ることができ、クラウドネイティブやスケールアウトのワークロードの容量を増やすことができます。より多くの計算能力を必要とするワークロードに対しては、P-cores を搭載する次期インテル® Xeon® 6 プロセッサが最適です。P-cores 搭載インテル® Xeon® プロセッサを採用した Supermicro サーバは、データセンターの主力となる、AI、HPC、ストレージ、エッジのワークロードに対してコアあたりの最大限のパフォーマンスとアクセラレーションを提供します。

インテル® Xeon® 6 への早期アクセス

Supermicro では、インテル® Xeon® 6 プロセッサを搭載した新しい X14 システムを、早期アクセスプログラムを通じて、認定要件を満たしたお客様にいち早く提供しています。JumpStart サービスでは、テストと検証のために X14 サーバへの無償リモートアクセスを提供し、Early Ship プログラムでは、認定要件を満たしたお客様に製品版 CPU を搭載した X14 システムを正式なリリース前にお届けします。Supermicro の早期アクセスプログラムの詳細については、Supermicro の担当者にお問い合わせいただくか、[supermicro.com/X14](https://www.supermicro.com/X14) をご覧ください。





X14

GPU サーバー (Coming Soon)

生成 AI、HPC、メディア・アプリケーション向けに最適化された統合パフォーマンス

8U SuperBlade

最高密度のマルチノード・サーバー・ソリューション

6U SuperBlade

EDA およびエンタープライズ・アプリケーション向けメモリー最適化マルチノード・アーキテクチャ

特徴

- 最も集約的な AI ワークロードのための次世代アーキテクチャ
- 最も包括的な AI ビルディング・ブロック・プラットフォーム
- OAM/SXM および PCIe GPU アクセラレータをサポート
- 最大 13 の PCIe 5.0 スロット
- 24 DDR5 DIMM スロット
- CPU と GPU のダイレクト・ツー・チップ液冷オプション

- ラックあたり 120 台のサーバー (最大 34,560CPU コア)
- 電源、冷却ファン、CMM、イーサネット、InfiniBand スイッチを共有
- 16 DDR5 DIMM スロット (最大 4TB メモリ)
- 400G IB またはイーサネット (OCP 3.0)、200G 統合 IB スイッチ、最大 4x 25G イーサネットスイッチ
- 再利用可能なエンクロージャー、電源、冷却ファン、CMM、スイッチにより、次世代サーバーに対応
- ダイレクト・ツー・チップ液冷オプション

- ラックあたり 100 台のサーバー (最大 28,800 CPU コア)
- 電源、冷却ファン、CMM、イーサネットスイッチを共有
- 最大 4 つの GPU またはネットワークカード
- 400G IB またはイーサネット (PCIe 5.0 x16 スロット)、100G アップリンク付き 25G イーサネットスイッチを最大 4 台まで搭載可能
- 再利用可能なエンクロージャー、電源、冷却ファン、CMM、スイッチにより、次世代サーバーに対応
- 96% の効率、(N+N / N+1) 冗長電源
- ダイレクト・ツー・チップ液冷オプション

主な用途

- 生成 AI
- 自然言語処理 (NLP)
- コンピュータビジョン
- 音声認識
- リアルタイム・コラボレーション
- 設計と可視化
- クラウドゲーム
- アニメーション / 3D レンダリング

- AI/ML 推論
- ハイブリッドクラウドとプライベートクラウド
- クラウドコンピューティング
- ビッグデータ分析
- 金融サービス
- HPC
- CDN
- vSAN
- EDA

- AI/ML 推論
- ハイブリッドクラウドとプライベートクラウド
- クラウドコンピューティング
- ビッグデータ分析
- 金融サービス
- HPC
- CDN
- vSAN
- EDA

フォームファクター

4U (液冷)、5U、または 8U ラックマウント

4U ブレード
8U エンクロージャーあたり 20/10 ノード

6U ブレード
6U エンクロージャーあたり 10/5 ノード

ソケット数 / タイプ

デュアル・インテル® Xeon® 6 プロセッサ

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 SuperBlade は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 SuperBlade は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

GPU の互換性

最大 8 基の OAM/SXM または 10 基の PCIe GPU

最大 4GPU

ストレージ

最大 24 台の U.2 NVMe

5 台の NVMe SSD (4 台の E1.S と 1 台の M.2)

最大 10 台の NVMe SSD (8 台の E3.S と 2 台の M.2)



X14

Hyper

最高クラスのパフォーマンスと柔軟性を持つラックマウントサーバー

Hyper-E

エッジデータセンター向けの最高のパフォーマンスと柔軟性

CloudDC (DC-MHS 対応)

OCP DC-MHS に準拠して設計されたクラウドデータセンター向けオールインワン・ラックマウントプラットフォーム

特徴

- インテル® Xeon® 6 プロセッサ (コードネーム: Sierra Forest および Granite Rapids) をサポートするシングルおよびデュアルソケット構成
- システムあたり最大 32 DIMM の DDR5 をサポート
- 最大 2 つの AIOM ネットワークスロット (OCP NIC 3.0 互換) による柔軟なネットワークオプション
- 最大 8 基の PCIe 5.0 x8 または 4 基の PCIe 5.0 x16 スロット (オプション)、ダブルワイド GPU/ アクセラレータカード対応
- オプションのダイレクト・ツー・チップ液冷
- 900W から 2600W までのチタニウムレベル (96%) の冗長電源

- エッジ用途の展開に最適なコンパクトなフォームファクターの高密度処理能力
- 最大 2 基の AIOM PCIe 5.0 と 8 基の PCIe 5.0 スロットによる柔軟な I/O 冗長電源による AC/DC 電源構成の両方が利用可能
- -5°C ~ 55°C の拡張動作温度 (CPU TDP に依存)
- フロントまたはリア I/O 構成が可能

- ノードあたり最大 32 DIMM の DDR5 をサポート
- PCIe 5.0 および CXL 2.0 をサポート
- OCP データセンター・モジュラー・ハードウェア・システム (DC-MHS) に基づくアーキテクチャ

主な用途

- エンタープライズ・サーバー
- クラウドコンピューティング
- ビッグデータ分析
- ハイパーコンバージド・ストレージ
- AI 推論と機械学習
- ネットワーク機能
- 仮想化

- 5G コアとエッジ
- テレコマイクロデータセンター

- プライベート / パブリック / ハイブリッドクラウド
- クラウド・コンピューティング
- ビッグデータ分析
- AI 推論
- 機械学習
- ネットワーク・アプライアンス
- 仮想化
- オープン BMC
- CSP 向け ODM カスタムデザイン
- ハイパースケーラー

フォームファクター

1U または 2U ラックマウント

2U ラックマウント

1U または 2U ラックマウント

ソケット数 / タイプ

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 Hyper は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 Hyper-E は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 CloudDC は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

GPU の互換性

最大 4 基のダブルワイド GPU または 4 基のシングルワイド GPU

最大 3 基のダブルワイド GPU または 4 基のシングルワイド GPU

最大 3 基のダブルワイド GPU または 6 基のシングルワイド GPU

ストレージ

ホットスワップ対応 NVMe/SAS/SATA のオールハイブリッド; 最大 24 ドライブベイ

ホットスワップ対応 NVMe/SAS/SATA のオールハイブリッド; 最大 24 ドライブベイ

オールハイブリッド・オプションの U.2 NVMe/SAS/SATA ドライブ



X14

BigTwin®

業界をリードするマルチノード・アーキテクチャ

GrandTwin®

シングルプロセッサのパフォーマンスに最適化されたマルチノード・アーキテクチャ

特徴

- 高度に構成可能な 2U 4 ノードおよび 2U 2 ノードシステム
- 密度またはストレージ用に最適化
- 最適化された熱設計
- オプションのダイレクト・ツー・チップ液冷により、拡張スロットを犠牲にすることなく、熱容量を増加させることが可能
- ノードあたり最大 16 DIMM の DDR5 をサポート
- オールハイブリッドのホットスワップ対応 NVMe/SAS/SATA ドライブベイと新しい E3.S 構成により、ストレージ密度を向上
- ノードあたり最大 400G イーサネットによる柔軟なネットワークング
- 2200W から 3600W までの幅広い電源容量をサポート

- ノードあたり最大 16 DIMM の DDR5 をサポート
- PCIe 5.0 および CXL 2.0 をサポート
- コールドアイルサービスを簡素化するフロント I/O 構成
- オプションで EDSSD E1.S NVMe ドライブをサポート

主な用途

- HCI
- HPC
- CDN
- ハイブリッド・クラウド
- コンテナ・アズ・ア・サービス
- クラウド・コンピューティング
- ビッグデータ分析
- バックアップとリカバリ
- スケールアウト・ストレージ

- MEC (マルチアクセス・エッジコンピューティング)
- HPC
- クラウド・ゲーミング
- 多目的 CDN
- 高可用性キャッシュ・クラスタ
- 通信・エッジ・クラウド
- EDA (電子設計自動化)
- ミッションクリティカルなウェブアプリケーション

フォームファクター

2U2N および 2U4N ラックマウント

2U4N ラックマウント

ソケット数 / タイプ

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 BigTwin® は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 GrandTwin® は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

ストレージ

E3.S、2.5 インチ NVMe/SAS/SATA または 3.5 インチ NVMe/SAS

2.5 インチ NVMe または E1.S NVMe



X14

UP WIO

業界で最も豊富な種類の I/O 最適化サーバー

通信 / エッジ

通信 / エッジ用途の展開に適したコンパクトで薄型のラックマウントシステム

特徴

- システムあたり最大 8 DIMM の DDR5 をサポート
- PCIe 5.0 および CXL 2.0 をサポート
- マザーボード上でネイティブ SATA をサポート、追加のコントローラカードは不要
- 1U と 2U の両方でダブルワイド GPU/FPGA カードをサポート

- エッジ展開に適したコンパクトなフォームファクターで高密度の処理能力を実現
- 1U で最大 3 スロット、2U で最大 4 スロットの PCIe 5.0 スロットを備えた柔軟な I/O
- 冗長電源により、AC 電源と DC 電源の両方の構成が可能
- 強化された動作温度範囲 -5° C ~ 55° C (CPU TDP に依存)

主な用途

- エンタープライズ・アプリケーション
- ネットワーク・アプライアンス
- ファイアウォール / セキュリティ・アプライアンス
- 汎用コンピューティング
- クラウド・コンピューティング
- メディア・エンターテインメント

- マルチアクセス・エッジコンピューティング
- フレックス RAN/ オープン RAN
- エッジ AI アウトドア 5G

フォームファクター

1U または 2U ラックマウント

1U ラックマウント、2U ラックマウント、コンパクトボックスサーバー

ソケット数 / タイプ

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 WIO は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
X14 通信 / エッジは、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

ストレージ

U.2 NVMe/SAS/SATA ドライブ、最大 8 台のハイブリッド・ドライブに対応

U.2 NVMe/SATA, M.2



X14

ベタスケール・オールフラッシュ
低レイテンシー、高スループット・ストレージを実現

特徴

- デュアル・ソケットの E-cores 搭載 インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
- X14 Petascale All-Flash は、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定
- DDR5-6400 をサポートする 32 DIMM スロット / ノード
- 最大 2 つの PCIe Gen 5 AIOM スロットと 3 つの PCIe Gen 5 スロット
- 最新の業界標準 EDSFF E3.S ドライブ・フォーム・ファクタおよびすべての主要 SSD ベンダーの Gen5 ドライブをサポート
- 最大 2TB の追加メモリを提供するオプションの CXL サポート
- オプションで最大 TDP 300W のダブルワイド GPU をサポート
- レイテンシーを最小化し、重要なコンポーネントのエアフローを最大化するように設計

主な用途

- AI/ ディープラーニングのトレーニングと推論
- データ集約型 HPC
- インメモリ・コンピューティング
- NVMe Over Fabrics ソリューション
- プライベート&ハイブリッド・クラウド
- スケールアウト オールフラッシュ NVMe ストレージ
- ソフトウェア・デファインド・ストレージ

フォームファクター

1U または 2U ラックマウント

ソケット数 / タイプ

デュアル・インテル® Xeon® 6700 シリーズ・プロセッサ
ベタスケール・オールフラッシュは、25 年第 1 四半期に P-cores を搭載したインテル® Xeon 6700 をサポート予定。

ストレージ

E3.S および CXL 2.0 x8 タイプ 3 デバイス



お問い合わせ：スーパーマイクロ株式会社

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスター 21 階

電話：03-5728-5196 FAX：03-5728-5197 Email：Sales_Inquiry_JP@Supermicro.com